

## DOMANDA - DIREZIONE DI RACLATURA

Scritto da MIGLIORE - 13/06/2019 22:35

---

Ciao a tutti,

sto sbrogliando una scheda elettronica con un TQFP144 e TSSOP32, ecco le foto dei chip:

<https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/LssAAOSw4ZRbaw9z/s-l225.jpg>

[https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/332220995519\\_/5PCS-X-CY62128DV30LL-70ZI-Cypress-IC-SRAM-1MBIT-70NS.jpg](https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/332220995519_/5PCS-X-CY62128DV30LL-70ZI-Cypress-IC-SRAM-1MBIT-70NS.jpg)

Il TQFP e' quadrato mentre il TSSOP32 e' rettangolare e ha pin solo su 2 lati.

Sono alla seconda revisione di prototipi.

Mi sono accorto che RACLANDO MANUALMENTE la revisione 1 di questa scheda la quantita' di pasta trasferita sui pad dipendeva dalla direzione di raclatura.

In particolare mi sono accorto che la pasta sul TSSOP32 era sempre scarsa proprio perche' raclavo perpendicolarmente alla fila dei pin.

Se raclavo parallelamente ai pin del TSSOP32 allora il problema si sposta sul TQFP144.

Voi assemblatori siete a conoscenza di questo problema?

Con le serigrafiche automatiche il problema si presenta ancora?

Ciao e grazie,  
Enrico Migliore

=====

## Re:DOMANDA - DIREZIONE DI RACLATURA

Scritto da Qualità - 26/06/2019 16:59

---

Ciao Enrico,

la raclatura automatica ha una pressione quasi costante...secondo me il problema che evidenzi è dovuto al fatto che manualmente non riesci a gestire la forza di trascinamento della spatola.

Dalla mia esperienza la direzione di raclatura incide su alcune tipologie di depositi non conformi non sulla quantità

=====

## Re:DOMANDA - DIREZIONE DI RACLATURA

Scritto da MIGLIORE - 27/06/2019 22:27

---

Ciao,

ottimo, grazie per la risposta.

Enrico Migliore

=====